```
6/9/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
009070096
WPI Acc No: 1992-197497/199224
XRAM Acc No: C92-090106
 Moulding appts. for large mouldings e.g. septic tank - includes
stopper
 pins protruding from lower inclined mould surface to support flexible
 moulding material, and prevent slipping from desired position
Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (MATW )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002
Patent Family:
Patent No
             Kind
                     Date
                             Applicat No
                                            Kind
                                                   Date
                                                            Week
                                                            199224 B
                   19920501
                             JP 90255851
                                                 19900925
JP 4131224
              Α
                                             Α
JP 2931062
               B2 19990809 JP 90255851
                                             Α
                                                 19900925
Priority Applications (No Type Date): JP 90255851 A 19900925
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                                     Filing Notes
                         Main IPC
                     4 B29C-051/30
JP 4131224
             Α
JP 2931062
              B2
                     4 B29C-051/30
                                    Previous Publ. patent JP 4131224
Abstract (Basic): JP 4131224 A
        Mould large mouldings, e.g. septic tank, comprises upper and
lower
    moulds, equipped with an arc-shaped and inclined moulding surface
    material stopper to stay moulding material on the lower mould. The
    stopper comprises pins capable of protruding from the inclined
moulding
    surface by using a cylinder to support a flexible moulding
material, by
    sticking it when it is placed on the lower mould. Pins are
retreated
    when both moulds are closed.
         USE/ADVANTAGE - To place a flexible moulding material on an
    inclined moulding surface before moulds are closed to prevent the
    moulding material from sliding from a desired position.
        Dwg.0/11
Title Terms: MOULD; APPARATUS; MOULD; SEPTIC; TANK; STOPPER; PIN;
PROTRUDE:
  LOWER; INCLINE; MOULD; SURFACE; SUPPORT; FLEXIBLE; MOULD; MATERIAL;
  PREVENT; SLIP; POSITION
Derwent Class: A32
International Patent Class (Main): B29C-051/30
International Patent Class (Additional): B29C-051/26
File Segment: CPI
Manual Codes (CPI/A-N): All-B08; Al2-P05
Plasdoc Codes (KS): 0223 0229 2348 2353 2372 2464 2545 2628 2692 2788
3241
Polymer Fragment Codes (PF):
  *001* 014 03- 274 371 377 380 381 388 456 459 476 54& 551 560 566 602
613
        655 721 022 234 235 237 246 254 262 269 278 324
```

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-131224

⑤lnt.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月1日

B 29 C 51/30 51/26 7722-4F 7722-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 成形金型

②特 願 平2-255851

②出 願 平2(1990)9月25日

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 月 茂 樹 明 髙 @発 者 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 浦 秀 樹 @発 明 者 箕 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 和 宏 @発 明 者 谷 村 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 羅 忠 夫 @発 明 渚 髙 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社 願 人 の出 外2名 個代 理 ・弁理士 石田 長七

明相の書

1. 発明の名称

成形金型

2. 特許請求の範囲

(1)成形材料を下型上に載設させて上型を下降させて成形をおこなう成形金型であって、下型における傾斜金型面に成形材料の滑りを阻止する材料係止手段が備えられて成る成形金型。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、主として浄化槽のような大型品を成形する成形金型に関し、詳しくは成形に際して成形材料のずれを抑えようとする技術に係るものである。

[従来例の技術]

従来、成形材料を下型上に載設させて上型を下降させて成形をおこなう成形金型において、下型に円弧状のような傾斜金型面が形成されいる場合には、その傾斜金型面に載設された成形材料が成形材料自体の重さで滑りやすく、また、下型から

の加熱にて軟化した成形材料が滑るものである。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、このように成形材料が滑る場合には 、成形不良が生じ、不良品を成形することになる という同題があった。

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、傾斜金型面が形成されていても傾斜金型面から成形材料が滑ることがなく、良好な成形をおこなうことができる成形金型を提供するにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の成形金型は、成形材料14を下型2上に載数させて上型3を下降させて成形をおこなう成形金型であって、下型2における傾斜金型面4に成形材料1の滑りを阻止する材料係止手段5が備えられて成ることを特徴とするものである。

[作用]

このように、下型2における傾斜金型面4に成形材料1の滑りを阻止する材料係止手段5が備えられることによって、傾斜金型面4に成形材料1

を載せてもこれを材料係止手段5にて係止して、 成形材料1の滑りを阻止し、成形不良を回避し、 良好な成形をおこなえるようにしたものである。

〔寒施例〕

₹.

以下本発明を添付図面に示す実施例に基づいて 詳述する。

成形金型Aは上型3と下型2からなり、成形材料1を下型2上に載せて上型3を下降させて成形がおこなわれるものである。下型2には略円弧状の傾斜金型面4が形成されている。そしてこの傾斜金型面4に成形材料1の滑りを阻止する材料係止手段5が備えられている。

材料係止手段5は第1図及び第2図に示すように、シリンダー6にて複数本のピン7が下型2の傾斜金型面4から突出引退自在に設けられ、傾斜金型面4に載せられた柔軟性がある成形材料1内にピン7が突入して成形材料1を保持する構造のものである。しかして傾斜金型面4に成形材料1が載せられた後、もしくは載せられる前にピン7を突出させて、ピン7を成形材料1内に突入させ

の側面図、第7図(b)は浄化樹11の平面図を 示している。断面が略り字型になるとともにその 周線にフランジ12が形成された上下の中央部材 13は側面視において第7図(c)(d)のよう にその両側が開くように鈍角(90°+X°)に なっていて、上金型が容易に抜けるようにしてあ る。そしてこのような抜き勾配を付けられた中央 部材13に接合される端部部材14は鋭角(90 * - X*)となっていて、かかる角度においては 上型3が真上には抜けないので、第8図のように 下型2にX。以上の角度Y。を設けて、上型3を 上方に抜けるようにしたものである。中央部材1 3にX*の抜き勾配を付けるのは、抜き勾配を付 けない場合には、上金型と下金型との間で成形材 料1をそのエッジ部分でシァー切断がおこなわれ ることになり、成形不良が生じるものである。

第9図は中央部材13、13間に第10図に示すようなスペーサー15を介在させて、上記鈍角(90°+×°)となって抜き勾配が形成された中央部材13、13回士を接続するようにしたも

て保持し、しかる後、上型3を下降させて成形が おこなわれるのである。そしてピン7は成形時に 下降させて退避させておく。

このように、下型2における傾斜金型面4に成形材料1の滑りを阻止する材料係止手段5が備えられることで、傾斜金型面4に成形材料1を載せてもこれを材料係止手段5にて係止して、成形材料1の滑りを阻止し、成形不良を回避し、良好な成形をおこなえるのである。

第3図は材料係止手段5の他の実施倒を示していて、ばね8にてピンフを傾斜金型面4から突出付勢したものであり、そして上型3にはピンフに相当する位置にピン押し込み体10が設けられ、上型3の下降にてピン押し込み体10にてピンフを下型2内に引退するようにしたものである。また、第6図に示すように材料係止手段5は傾斜金型面4に凹凸部9を形成したものでもよいものである。このように材料係止手段5の構成は種々設計変更可能である。

第7図(a)は大型成型品としての浄化槽11

のである。そしてスペーサー15は環状に一体成形したものでも別体にしたものでもよい。第11 図は中央部材13.13同士の締結状態を示していて、スペーサー15は中央部材13の外周と等しくなるようにしてある。かかるスペーサー15 において、抜き勾配を付けた成型品同士の接続が可能になり、かつスペーサー15にて強度を高める補強機能を発揮する。図中16はシール剤または接着剤のような水密剤、17は締結ボルトである。

[発明の効果]

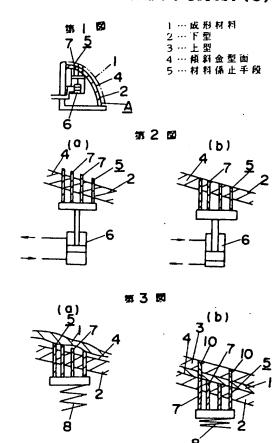
以上要するに本発明は、下型における傾斜金型面に成形材料の滑りを阻止する材料係止手段が構えられるから、傾斜金型面に成形材料を載せてもこれを材料係止手段にて係止でき、成形材料1の滑りを阻止でき、成形不良を回避し、良好な成形をおこなえるという利点がある。

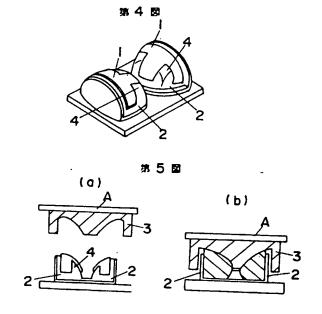
4. 図面の簡単な説明

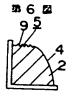
第1 図は本発明の一実施例の下型の優略断面図 、第2 図(a)(b)は同上の材料係止手段の作 用を示す断面図、第3図(a)(b)は同上の他の実施例の成形作用を示す断面図、第4図は同上のでの下型に成形材料を載せた状態の斜視図、第5図(a)(b)は同上のが移動をを示す説明ののでは同上の材料係止手段の他の実施例の断面図、第6図は同上の材料係止手段の他の実施例の断面図、第7図(a)は同上の故を回回図、平面図、第7図(c)(d)は同上の技を勾配を説明図、第8図である。は同上の技に同上の下型のないでは、第8図では同上の下型のは同上の中央部材同士の接続作用を示す側面図、第10図(a)(c)は同上のスペーサーの斜視図、同上のスペーサーの一方の半体の正面図、他の実施例の正面図、第11回上の接続状態の側面図である。

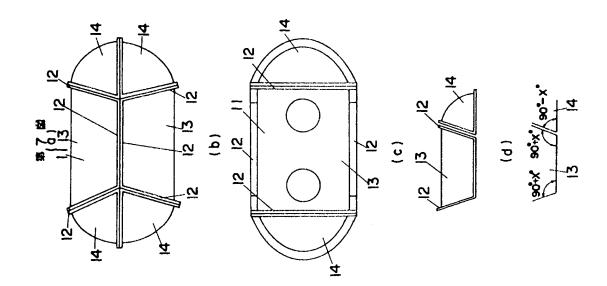
1 ···成形材料、2 ···下型、3 ···上型、4 ···傾斜 金型面、5 ···材料係止手段。

代理人 弁理士 石 田 長 七









· · · . &

